

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-026

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

为满足公司及控股子公司日常生产经营及项目建设资金的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池、金融衍生品、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。在授信有效期内签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

公司董事会提请公司股东会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本事项已经得第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年

度股东会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日